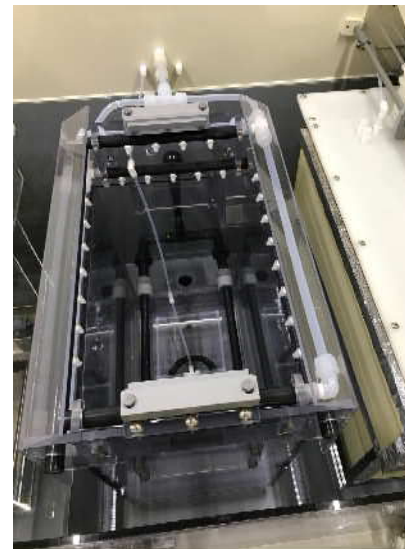




# UBM/PLP めっき装置 Plating System for UBM / PLP

スピードプレーター / SpeedPlater

## ◆装置全体図 Overall view of the equipment



For UBM  
(QDR tank)



For PLP  
(Sparger agitation)

## ◆UBM用(無電解めっき) Electroless plating for UBM

**SPEEDPlater** UBM

- Waferサイズ : 6, 8, 12 インチ  
Wafer diameter : 6, 8 or 12 inch
- 各種UBMプロセスに対応  
Support to various UBM processes

## ◆PLP用(電気めっき) Electrolytic plating for PLP

**SPEEDPlater** EC

- 基板サイズ : 最大650 x 550 mm  
Panel size: Maximum 650 x 550 mm
- 高速電気めっき、最大電流密度 : 25 A/dm<sup>2</sup>  
High speed electrolytic plating, Maximum current density:  
25 A/dm<sup>2</sup>